

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯國際截至二零一三年六月三十日止三個月未經審核業績公佈

- 二零一三年第二季銷售額為伍億肆仟壹佰參拾萬元，連續五個季度錄得銷售額新高，與二零一二年第二季相比增長 28.3%，與二零一三年第一季相比增長 7.9%。
- 二零一三年第二季中國區銷售額佔總銷售額的比率是創新高的 40.9%，二零一二年第二季為 32.7%，二零一三年第一季為 38.6%。
- 二零一三年第二季毛利是創新高的壹億參仟伍佰貳拾萬元，二零一二年第二季是壹億零壹佰柒拾萬元，二零一三年第一季是玖仟捌佰參拾萬元。
- 二零一三年第二季毛利率為 25.0%，二零一二年第二季為 24.1%，二零一三年第一季為 19.6%。
- 二零一三年第二季的中芯國際應佔盈利為柒仟伍佰肆拾萬元，是二零一二年第二季的應佔盈利柒佰壹拾萬元的十倍多，較二零一三年第一季的應佔盈利肆仟零陸拾萬元增長了 85.7%。

以下為本公司於二零一三年八月八日就截至二零一三年六月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

本公司自二零一二年起依國際財務報告準則編製年度合併財務報告，所有前期可比較財務資訊已按照國際財務報告準則之規定予以重分類。

中國上海 — 2013 年 08 月 08 日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一三年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一三年第三季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 不包含來自武漢新芯的銷售額，季度收入預期下降 1% 至上升 2%，來自武漢新芯的銷售額將於二零一三年第三季起逐步結束。
- 包含來自武漢新芯的銷售額，季度收入預期小幅下降 3% 至持平。
- 不包含來自武漢新芯的銷售額，毛利率預期在 18.5% 至 21.5% 範圍內。
- 包含來自武漢新芯的銷售額，毛利率預期在 17.5% 至 20.5% 範圍內。
- 經營開支扣除匯兌損益、在研究發展的合約上獲得政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響後，預期將介於 81 百萬元至 85 百萬元之間。

首席執行官兼執行董事邱慈雲博士評論說：“我很高興向各位報告，中芯國際在二零一三年第二季度取得優於市場預期的表現，銷售額繼續創新高，達到 5 億 4 千 1 百 30 萬元，比二零一二年第二季度增長 28.3%，比二零一三年第一季度增長 7.9%。二零一三年第二季度產能利用率上升至 98.5%，而二零一二年第二季度和二零一三年第一季度的產能利用率分別是 95.2% 和 89%。毛利和經營利潤同創新高，分別達到了 1 億 3 千 5 百 20 萬元和 7 千 9 百 10 萬元。”

“二零一三年第二季度我們來自中國客戶的銷售額比二零一三年第一季度增長了 14.3%，比二零一二年第二季度增長了 60.6%，來自中國客戶的銷售額約占公司第二季銷售額的 40.9%，再創新高。在二零一三年第二季度，我們 40/45 納米制程貢獻的銷售額比上一季增長 71.9%，對晶圓銷售額的貢獻從從二零一三年第一季度的 6.4% 上升至二零一三年第二季度的 10.0%。”

“市場對我們差異化產品的需求持續走強，特別是電源管理、攝像頭芯片及 EEPROM 這一塊。為了進一步抓住市場機遇，提升我們在差異化技術領域的地位，我們正在仔細評估各種擴充 8 英寸產能的機會。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一三年八月九日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：

中國 400-620-8038 （密碼：SMIC）

香港 852-2475-0994 （密碼：SMIC）

臺灣 886-2-2650-7825 （密碼：SMIC）

美國 1-845-675-0437 （密碼：SMIC）

二零一三年第二季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php，或

<http://www.media-server.com/m/p/8s7n2w4d>。

該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司（“中芯國際”， 紐交所代號：SMI，港交所股份代號：981），是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和一座 200mm 超大規模晶圓廠。在北京建有一座 300mm 超大規模晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳正開發一個 200mm 晶圓廠項目。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區提供客戶服務和設立行銷辦事處，同時在香港設立了代表處。

詳細資訊請參考中芯國際網站 www.smics.com

安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一三年第三季指引所述”以及仔細評估各種擴充8英寸產能的機會等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。這些前瞻性陳述涉及可能導致中芯國際實際表現、財務狀況和經營業績與這些前瞻性陳述所表明的意見產生重大差異的已知和未知風險、不確定性因素和其他因素，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，其中包括全球經濟變緩、未決訴訟的頒令或判決，和終端市場的財政穩定等相關風險。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文檔資料，包括其於二零一三年四月十五日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「合併財務報表」部分，且中芯不時向證交會 (包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性陳述，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明陳述的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因為新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

二零一三年第二季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度	二零一二年 季度比較	二零一二年 第二季度	二零一二年 年度比較
收入	541,302	501,609	7.9%	421,825	28.3%
銷售成本 ⁽³⁾	(406,075)	(403,321)	0.7%	(320,110)	26.9%
毛利	135,227	98,288	37.6%	101,715	32.9%
經營開支 ⁽³⁾	(56,095)	(46,967)	19.4%	(87,973)	-36.2%
經營利潤	79,132	51,321	54.2%	13,742	475.8%
其他開支，淨額	(3,292)	(8,273)	-60.2%	(8,188)	-59.8%
除稅前利潤	75,840	43,048	76.2%	5,554	1265.5%
所得稅利益(開支)	(510)	(2,536)	-79.9%	1,461	-
本期利潤	75,330	40,512	85.9%	7,015	973.8%
其他綜合收入					
外幣報表折算差異變動	278	43	546.5%	(230)	-
本期綜合收入總額	75,608	40,555	86.4%	6,785	1014.3%
中芯國際應佔利潤	75,401	40,604	85.7%	7,060	968.0%
毛利率	25.0%	19.6%	-	24.1%	-
每股普通股股份盈利-基本及攤薄 ⁽¹⁾	0.00	0.00	-	0.00	-
每股美國預托股份盈利-基本及攤薄	0.12	0.06	-	0.01	-
付運晶圓(約當 8 吋)	687,651	631,776	8.8%	557,683	23.3%
產能利用率 ⁽²⁾	98.5%	89.0%	-	95.2%	-

附注：

- (1) 基於二零一三年第二季加權平均普通股 320 億 5 仟 100 萬股(基本)及 323 億 1 仟 200 萬股(攤薄)，二零一三年第一季 320 億 1 仟 400 萬股(基本)及 321 億 8 仟 200 萬股(攤薄)，二零一二年第二季 287 億 8 仟 900 萬股(基本)及 288 億零 3 仟萬股(攤薄)。
- (2) 產能利用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。
- (3) 本公司就二零一三年第一季包含在經營開支內的僱員花紅，於銷售成本及經營開支項下進行重分類。

- 二零一三年第二季銷售額由二零一三年第一季的 5 億零 1 佰 60 萬元上升 7.9%至 5 億 4 仟 1 佰 30 萬元，主要由於晶圓付運量增加。
- 二零一三年第二季來自武漢新芯轉單的銷售額為 3 仟 9 佰 50 萬元，二零一三年第一季為 2 仟 9 佰 20 萬元，這部分的銷售額將自二零一三年第三季起逐步結束。
- 二零一三年第二季的銷售成本為 4 億零 6 佰 10 萬元，較二零一三年第一季的 4 億零 3 佰 30 萬元增加，除晶圓付運量的增加外，主要是由於本季產能利用率顯著上升，造成折舊開支被分配到增量的晶圓產出裡。

- 二零一三年第二季的毛利與二零一三年第一季的 9 仟 8 佰 30 萬元相比增加 37.6%至 1 億 3 仟 5 佰 20 萬元。
- 二零一三年第二季的毛利率由二零一三年第一季的 19.6%上升至 25.0%，主要由於本季產能利用率顯著上升。
- 二零一三年第二季的經營開支由二零一三年第一季的 4 仟 7 佰萬元增加 19.4%至 5 仟 6 佰 10 萬元，主要原因請詳經營開支（收入）分析。
- 二零一三年第二季的所得稅開支與二零一三年第一季的 2 佰 50 萬元相比減少 79.9%至 50 萬元，主要由於二零一三年第二季本公司出售的部分上海生活園區資產較第一季減少，造成所得稅開支也減少。

收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度	二零一二年 第二季度
電腦	1.5%	1.3%	2.6%
通訊	45.6%	47.3%	41.1%
消費	45.3%	42.5%	47.8%
其他	7.6%	8.9%	8.5%
以服務分類	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度	二零一二年 第二季度
晶圓	96.2%	94.1%	94.4%
光罩製造，晶圓測試及其它	3.8%	5.9%	5.6%
以客戶類別分類	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度	二零一二年 第二季度
無廠房半導體公司	87.7%	88.7%	87.4%
集成裝置製造商	7.0%	6.1%	9.4%
系統公司及其它	5.3%	5.2%	3.2%
以地區分類	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度	二零一二年 第二季度
北美洲	48.3%	51.4%	56.3%
中國 ⁽¹⁾	40.9%	38.6%	32.7%
歐亞 ⁽²⁾	10.8%	10.0%	11.0%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度	二零一二年 第二季度
40/45 納米	10.0%	6.4%	0.2%
55/65 納米	30.9%	32.1%	32.8%
90 納米	4.6%	6.7%	8.7%
0.13 微米	10.5%	10.7%	15.5%
0.15/0.18 微米	40.1%	39.9%	36.5%
0.25/0.35 微米	3.9%	4.2%	6.3%

附註：

- (1) 包括香港，不包括臺灣
- (2) 不包括中國

產能*

晶圓廠／(晶圓尺寸)	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度
上海廠(8吋)	90,000	90,000
上海 12吋廠(12吋)	18,000	14,150
北京廠(12吋)	81,000	81,000
天津廠(8吋)	34,500	34,450
晶圓代工生產月產能合計	223,500	219,600

附注：

*在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數，且爲了比較目的，以 30 天作爲計算基礎。

- 二零一三年第二季的月產能由二零一三年第一季的 21 萬 9 仟 600 片 8 吋晶圓增長至 22 萬 3 仟 500 片晶圓，主要由於上海 12 吋廠的產能擴充。

付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度	二零一二年 季度比較	二零一二年 第二季度	二零一二年 年度比較
付運晶圓	687,651	631,776	8.8%	557,683	23.3%
產能利用率 ⁽¹⁾	98.5%	89.0%	-	95.2%	-

附注：

(1) 產能使用率按約當產出品圓總額除以估計季度產能計算。

詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度	季度比較	二零一二年 第二季度	年度比較
銷售成本	406,075	403,321	0.7%	320,110	26.9%
折舊	107,759	127,339	-15.4%	91,184	18.2%
其他製造成本	295,840	275,537	7.4%	228,344	29.6%
股權報酬	2,476	445	456.4%	582	325.4%
毛利	135,227	98,288	37.6%	101,715	32.9%
毛利率	25.0%	19.6%	-	24.1%	-

- 二零一三年第二季的銷售成本與二零一三年第一季的4億零3百30萬元相比上升0.7%至4億零6百10萬元。
- 二零一三年第二季歸屬於銷售成本的折舊相較於二零一三年第一季減少，主要由於本季產能利用率顯著上升，造成折舊開支被分配到增量的晶圓產出裡，以及季末的存貨成本裡。
- 二零一三年第二季歸屬於銷售成本的其他製造成本相較於二零一三年第一季增加，主要由於晶圓付運量增加所致。
- 二零一三年第二季的毛利與二零一三年第一季的毛利9仟8百30萬元相比上升37.6%至1億3仟5百20萬元。
- 二零一三年第二季的毛利率由二零一三年第一季的19.6%上升至25.0%，主要由於本季產能利用率顯著上升所致。

經營開支（收入）分析

以千美元計	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度	季度比較	二零一二年 第二季度	年度比較
經營開支	56,095	46,967	19.4%	87,973	-36.2%
研究及開發	36,736	24,758	48.4%	51,021	-28.0%
一般及行政開支	42,636	34,203	24.7%	29,093	46.6%
銷售及市場推廣開支	9,775	8,254	18.4%	7,786	25.5%
其他經營開支(收入)	(33,052)	(20,248)	63.2%	73	-

- 二零一三年第二季的研究及開發開支3仟6百70萬元，與二零一三年第一季的2仟4百80萬元相比上升48.4%，主要由於1) 本季在研究發展的合約上獲得政府支持可抵銷成本的資金減少了7百50萬元，及2) 本季僱員花紅計提增加所致。
- 二零一三年第二季的一般及行政開支由二零一三年第一季的3仟4百20萬元上升24.7%至4仟2百60萬元，主要由於本季僱員花紅計提較多所致。
- 二零一三年第二季的其他經營開支（收入）包含1) 處置部分上海生活園區資產所產生的收益及2) 處置本公司對中芯國際開發管理（武漢）有限公司的全部所有權所產生的收益，該公司主要從事建造、經營及管理中芯國際在武漢的宿舍和學校。

其他收入（開支），淨額

以千美元計	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度	季度比較	二零一二年 第二季度	年度比較
其他收入（開支），淨額	(3,292)	(8,273)	-60.2%	(8,188)	-59.8%
利息收入	936	1,352	-30.8%	1,827	-48.8%
財務費用	(9,080)	(10,850)	-16.3%	(10,174)	-10.8%
外幣匯兌收益或虧損	2,949	2,145	37.5%	(2,336)	-
其他收益或虧損	1,126	(1,366)	-	2,054	-45.2%
應佔聯營公司利潤	777	446	74.2%	441	76.2%

- 二零一三年第二季的財務費用 9 佰 10 萬元，與二零一三年第一季的 1 仟零 90 萬元相比下降 16.3%，主要由於 1) 本公司在本季初償還部分借款及 2) 本季有較多建造中資產成本的利息開支被資本化。
- 其他收益或虧損的變動，主要由於二零一三年第一季支付政府徵收的土地閒置稅。

折舊及攤銷

以千美元計	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度	季度比較	二零一二年 第二季度	年度比較
折舊及攤銷	135,712	135,752	-0.0%	140,770	-3.6%

流動資金

以千美元計	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度
現金及銀行結餘	262,955	292,932
限制性現金	214,430	185,031
其他財務資產	2,881	1,239
貿易及其他應收賬款	472,426	355,293
預付經營開支	57,231	51,061
存貨	308,328	284,653
歸類為持作出售資產	922	1,428
流動資產總計	1,319,173	1,171,637
流動稅項負債	143	60
其他財務負債	107	8
承兌票據	14,791	29,582
預提負債	104,678	73,696
借貸	586,425	529,440
貿易及其他應付款項	537,003	459,235
流動負債總計	1,243,147	1,092,021
現金比率	0.2x	0.3x
速動比率	0.8x	0.8x
流動比率	1.1x	1.1x

資本結構

以千美元計	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度
現金及現金等價物	262,955	292,932
限制性現金	214,430	185,031
長期票據即期部分	14,791	29,582
短期借款	586,425	529,440
長期借款	474,692	429,000
借款總計	1,061,117	958,440
股本	2,403,738	2,319,036
總債務股本比率 ⁽¹⁾	44.1%	41.3%

附注：

(1) 總債務股本比率為借款總計除以股本。借款總計包含短期借款和長期借款。

現金流量概要

以千美元計	二零一三年 第二季度	二零一三年 第一季度
經營活動所得現金淨額	108,360	154,638
投資活動所用現金淨額	(242,559)	(82,628)
融資活動所得（所用）現金淨額	104,167	(137,503)
滙率變動的影響	55	(65)
現金變動淨額	(29,977)	(65,558)

資本開支概要

- 二零一三年第二季資本開支為 3 億零 1 佰 80 萬元。
- 計畫二零一三年用於晶圓廠運作的資本開支為 6 億 7 仟 5 佰萬元。
- 此外，本公司在二零一三年編列預算 1 億 3 仟萬元，用以建造僱員生活園區，此為留才計畫的一部分。本公司計畫於未來出租或出售園區內的房舍予僱員。

近期公佈

- 董事會會議日期通知 (2013-07-19)
- 授出購股期權 (2013-06-18)
- 董事名單與其角色和職能 (2013-06-18)
- 委任獨立非執行董事及董事調任 (2013-06-18)
- 董事名單與其角色和職能 (2013-06-13)
- (1) 二零一三年六月十三日舉行之股東週年大會投票表決結果 (2) 獨立非執行董事退任 (2013-06-13)
- 授出購股期權 (2013-06-11)
- 在中國北京成立合資企業 (2013-06-03)
- 中芯國際針對 40 及 28 納米舉辦先進技術研討會 (2013-05-30)
- 暫停辦理股份過戶登記 (2013-05-23)
- 通函—非登記股東之通知信函及申請表格 (2013-05-10)
- 通函—登記股東之通知信函 (2013-05-10)
- 委任代表表格—於二零一三年六月十三日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格 (2013-05-10)
- 通函—(1) 股東週年大會通告 (2) 重選董事 (3) 建議授出發行及購回股份之一般授權 (4) 採納新股份計劃及(5) 終止現有股份計劃 (2013-05-10)
- 股東週年大會通告 (2013-05-10)
- 授出購股期權 (2013-05-07)
- 中芯國際任命堀敦博士為日本區總經理 (2013-05-07)
- 通函—致新登記股東之信函及回條 - 選擇收取公司通訊文件之方式 (2013-04-29)
- 通函—非登記股東之通知信函及申請表格 (2013-04-29)
- 通函—登記股東之通知信函及變更申請表格 (2013-04-29)
- 委任首席運營官 (2013-04-26)
- 中芯國際截至二零一三年三月三十一日止三個月未經審核業績公佈 (2013-04-24)
- 中芯國際捐贈 200 萬元資助肝移植貧困兒童 (2013-04-12)
- 董事會會議日期通知 (2013-04-03)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php 及 http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

簡明合併綜合收入表

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一三年 六月三十日 (未經審核)	二零一三年 三月三十一日 (未經審核)
收入	541,302	501,609
銷售成本	(406,075)	(403,321)
毛利	135,227	98,288
研究及開發	(36,736)	(24,758)
一般及行政開支	(42,636)	(34,203)
銷售及市場推廣開支	(9,775)	(8,254)
其他經營收入	33,052	20,248
經營利潤	79,132	51,321
其他開支，淨額	(3,292)	(8,273)
除稅前利潤	75,840	43,048
所得稅開支	(510)	(2,536)
本期利潤	75,330	40,512
其他綜合收入		
<i>其後或會重新歸類為損益的項目</i>		
外幣報表折算差異變動	278	43
本期綜合收入總額	75,608	40,555
本期以下各方應佔利潤:		
本公司擁有人	75,401	40,604
非控制權益	(71)	(92)
	75,330	40,512
本期以下各方應佔其他綜合收入總額:		
本公司擁有人	75,679	40,647
非控制權益	(71)	(92)
	75,608	40,555
中芯國際應佔每股股份盈利，基本及攤薄	0.00	0.00
中芯國際應佔每股美國預托股份盈利，基本及攤薄	0.12	0.06
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	32,051,257,487	32,014,142,052
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	32,311,620,628	32,182,139,336

中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併財務狀況表
(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一三年 六月三十日 (未經審核)	二零一三年 三月三十一日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	2,523,893	2,443,230
預付土地使用權	124,818	73,576
無形資產	228,898	226,787
於聯營公司的投資	23,189	22,190
遞延稅項資產	43,802	43,461
其他資產	37,926	41,065
非流動總資產	2,982,526	2,850,309
<i>流動資產</i>		
存貨	308,328	284,653
預付經營開支	57,231	51,061
貿易及其他應收款項	472,426	355,293
其他財務資產	2,881	1,239
受限制現金	214,430	185,031
現金及銀行結餘	262,955	292,932
	1,318,251	1,170,209
歸類為持作出售資產	922	1,428
流動總資產	1,319,173	1,171,637
總資產	4,301,699	4,021,946
權益及負債		
<i>股本及儲備</i>		
普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股。於二零一三年六月三十日及二零一三年三月三十一日已發行及 流通股份分別為 32,075,631,400 股及 32,023,168,050 股。	12,830	12,809
股份溢價	4,088,071	4,084,942
儲備	53,079	46,857
累計虧絀	(1,751,031)	(1,826,432)
本公司擁有人應佔權益	2,402,949	2,318,176
非控制權益	789	860
總權益	2,403,738	2,319,036

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

簡明合併財務狀況表(續)

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一三年 六月三十日 (未經審核)	二零一三年 三月三十一日 (未經審核)
<i>非流動負債</i>		
借貸	474,692	429,000
遞延稅項負債	257	314
遞延政府補助	174,876	171,987
長期財務負債	4,989	4,588
其他負債	-	5,000
非流動總負債	654,814	610,889
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	537,003	459,235
借貸	586,425	529,440
預提負債	104,678	73,696
承兌票據	14,791	29,582
其他財務負債	107	8
流動稅項負債	143	60
流動總負債	1,243,147	1,092,021
總負債	1,897,961	1,702,910
權益及負債合計	4,301,699	4,021,946

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
簡明合併現金流量表
(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一三年 六月三十日 (未經審核)	二零一三年 三月三十一日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	75,330	40,512
折舊及攤銷	135,712	135,752
應佔聯營公司利潤	(777)	(446)
營運資金的變動及其它	(101, 905)	(21,180)
經營活動所得現金淨額	108,360	154,638
投資活動:		
對物業、廠房及設備的付款	(188,008)	(123,132)
對無形資產的付款	(14,914)	(14,580)
對土地使用權的付款	(61,391)	-
出售物業、廠房及設備及無形資產所得（支付） 款項	7,553	(8,416)
與投資活動有關的受限制現金變動	(12,721)	46,388
收購財務資產付款	(2,852)	(1,527)
出售財務資產所得款項	1,215	18,966
出售子公司股權所得款項	28,639	-
其他	(80)	(327)
投資活動所用現金淨額	(242,559)	(82,628)
融資活動:		
借款所得款項	306,939	55,675
償還借款	(189,323)	(193,745)
償還承兌票據	(15,000)	-
行使雇員認股權所得款項	1,551	567
融資活動所得（所用）現金淨額	104,167	(137,503)
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	55	(65)
現金及現金等價物減少淨額	(29,977)	(65,558)
現金及銀行結餘－期間開始	292,932	358,490
現金及銀行結餘－期間結束	262,955	292,932

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張文義(董事長)

邱慈雲(首席執行官)

高永崗

非執行董事

陳山枝

劉遵義(及其替任董事陳大同)

周杰

獨立非執行董事

William Tudor Brown

馬宏升 (Sean Maloney)

孟樸

陳立武

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

邱慈雲

首席執行官兼執行董事

中國上海

二零一三年八月八日

* 僅供識別